



PLANIX™ MEGATHERM HIGH

Composición

- Vermiculita expandida con aglutinante NBR
- Lámina de soporte perforada SS316L de 0,10 mm

Características

Las láminas de vermiculita expandida contribuyen a otorgar ligereza y resistencia térmica al producto, mientras que las fibras biosolubles termo-resistentes mejoran aún más la resistencia a altas temperaturas. Megatherm High muestra una notable flexibilidad y resiliencia de la junta, garantizando un excelente sellado. El soporte perforado en SS316L proporciona solidez estructural y facilita la instalación. Megatherm High está diseñado para resistir las aplicaciones más exigentes y las temperaturas extremas. Su formulación química única permite un uso fiable hasta 950°C, garantizando resistencia, durabilidad y fiabilidad incluso en condiciones críticas. La baja pérdida de peso del producto contribuye aún más a su rendimiento superior.

Aplicaciones

Gracias a su resistencia a altas temperaturas y su fiabilidad, Megatherm High es ideal para aplicaciones críticas donde otros productos podrían fallar. Encuentra un amplio uso en contextos industriales que requieren una junta resistente y duradera, garantizando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más extremas.

Datos técnicos

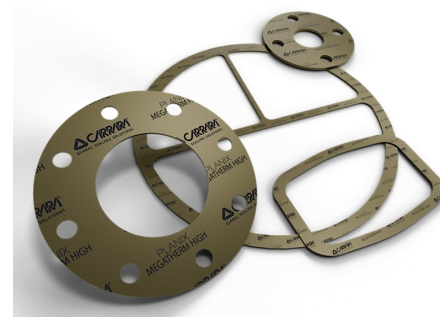
| Megatherm High | | |
|---|-------------------------------------|-------------|
| Material | -- | Vermiculite |
| Tanged Insert SS316L th. 0.10 mm | no. | 1 |
| Colour | -- | Gold Brown |
| Density | g/cm ³ | 1.60 ÷ 1.90 |
| Max recommended Temperature in Air | °C | 950 |
| Maximum Pressure Service (°C R.T./H.T.) | bar | 200 / 50 |
| Leakage DIN 3535-6 | mg·s ⁻¹ ·m ⁻¹ | < 0.10 |
| Creep Relaxation DIN 3535-6 | % | < 18 |
| Compressibility DIN 3535-6 | % | > 20 |
| Recovery DIN 3535-6 | % | > 2.20 |
| Weight Loss at 950°C after 60 min | % | < 5.00 |
| Thermal conductivity DIN 52612 | W/m·K | 0.20 |
| Dielectric Strength IEC 60243 | kV/mm | > 16 |

- Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
- Otras dimensiones y espesores están disponibles bajo pedido.
- Las tolerancias dimensionales de las juntas son: W y L +/- 3,0 %, H +/- 10,0 %

| | | |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| Tamaño | 1.000 x 1.000 mm / 1.500 x 1.500 mm | 40" x 40" / 60" x 60" |
| Espesor | 1.0 ÷ 3.0 mm | 3/64" ÷ 1/8" |



La información incluida en esta publicación, así como la ofrecida a los usuarios por otros medios, se basa en nuestra experiencia y se comunica según el mejor conocimiento disponible. Sin embargo, dado que numerosos factores fuera de nuestro conocimiento y control pueden influir en el uso de los productos, no se ofrece ninguna garantía, explícita ni implícita, respecto a dicho contenido. Los límites operativos indicados no constituyen confirmación de que dichos valores puedan aplicarse simultáneamente. Evite utilizar el producto en los límites máximos de temperatura y presión. La temperatura máxima solo puede mantenerse durante breves periodos en condiciones específicas. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. Las imágenes en el DS pueden no representar exactamente el producto, su color y/o su marcaje.



Planix™ Megatherm High

La gama Planix Megatherm incluye una selección completa de láminas para juntas destinadas a servicios de alta temperatura con fluidos oxidantes que no pueden ser manejados por juntas de grafito.

Los productos se fabrican tanto con vermiculita, tratada con fibras biosolubles especiales, como con mica flogopita para ofrecer a los clientes una amplia elección.

Las láminas sin refuerzo también son adecuadas como materiales aislantes gracias al alto valor dieléctrico de la vermiculita y la mica.

- **Planix Megatherm High**
 - Lámina de vermiculita con soporte metálico
- **Planix Megatherm R**
 - Lámina de mica flogopita con soporte metálico
- **Planix Megatherm S**
 - Lámina de mica flogopita sin soporte metálico



Carrara S.p.A.,
Via Provinciale 1/E - 25030 Adro - BS - Italia
tel. +39 030 7451121 carrara.it - info@carrara.it